

证券代码：688352

证券简称：颀中科技

公告编号：2026-007

转债代码：118059

转债简称：颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司

关于对外投资浙江禾芯集成电路有限公司

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：浙江禾芯集成电路有限公司（以下简称“禾芯集成”或“标的公司”）
- 投资金额：合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“颀中科技”）拟使用自有资金 5,000 万元对禾芯集成进行增资，认缴禾芯集成新增注册资本 2,600 万元，增资完成后将持有其 2.27% 的股权（具体比例以最终签署的增资协议为准），成为禾芯集成股东。
- 已履行的审议程序：本次对外投资事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议通过。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
- 相关风险提示：本次投资仍处于洽谈阶段，相关投资协议尚未签署。标的公司实际经营过程中可能受宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决

策，注意投资风险。

一、对外投资概述

(一) 本次交易概况

1、本次交易概况

为优化公司战略布局，拓展集成电路先进封装测试领域业务协同，公司拟以自有资金人民币 5,000 万元对禾芯集成进行增资。本次投资完成后，公司认缴禾芯集成新增注册资本 2,600 万元，增资完成后将持有其 2.27% 的股权，成为禾芯集成股东。本次交易不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资项目已按规定完成前期调研与可行性论证，投资金额及决策程序符合《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》及《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》的相关要求。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	浙江禾芯集成电路有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：5,000 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他： <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____

是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	------------------------------------------------------------------

(二) 董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于 2026 年 1 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于对外投资禾芯集成的议案》，公司董事会授权公司管理层全权办理本次投资相关的协议签署、工商变更登记、备案等一切事宜。本次对外投资事项无需提交股东会审议通过，尚需合肥市建设投资控股（集团）有限公司等有关部门批准。

(三) 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的概况

禾芯集成是一家专注于集成电路高端封测研发与制造的核心企业，深度布局信息通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子、智能终端等国家战略性新兴应用领域，为全球客户提供全流程、高可靠性的集成电路高端封装与测试一体化解决方案。禾芯集成已构建起覆盖晶圆级封装（WLP）、倒装芯片封装（FC）、系统级集成（SiP、2.5D/3D）、芯片测试四大核心领域的完整技术布局。凭借完善的技术体系与全流程服务能力，禾芯集成已成为国内先进封测领域的重要参与者，为下游产业链的技术升级与国产替代提供了关键支撑。

(二) 投资标的具体信息

1. 投资标的的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input type="checkbox"/> 同比例 <input checked="" type="checkbox"/> 非同比例)
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

标的公司类型（增资前）	未持股公司
法人/组织全称	浙江禾芯集成电路有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91330421MA2JFU4P1W <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	张黎
成立日期	2021/1/8
注册资本	105,716 万元
实缴资本	97,216 万元
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 189 号 H 座
主营业务	一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2. 标的增资前的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额	出资比例
		(万元)	(%)
1	嘉兴梓禾惠芯股权投资合伙企业（有限合伙）	26,600	25.1618
2	嘉善润信先进封测股权投资合伙企业（有限合伙）	14,850	14.0471
3	嘉善经开同创股权投资合伙企业（有限合伙）	14,850	14.0471
4	芯迈半导体技术（杭州）股份有限公司	10,000	9.4593
5	长三角（嘉善）建设发展集团有限公司	9,900	9.3647
6	宁波聚胜扬芯创业投资合伙企业（有限合伙）	9,300	8.7972
7	嘉善金芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,000	4.7297
8	嘉兴禾芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,000	4.7297

9	湖州芮芯股权投资合伙企业（有限合伙）	3,500	3.3108
10	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司	3,500	3.3108
11	聚源信诚（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）	1,560	1.4757
12	杭州芯岚微创业投资合伙企业（有限合伙）	1,500	1.4189
13	嘉兴晶虹投资合伙企业（有限合伙）	156	0.1476
合计		105,716	100.0000

3. 标的增资后的股权结构

本次增资完成后，公司将持有禾芯集成 2.27% 的股权。

（三）出资方式及相关情况

公司本次对外投资事项以现金方式进行增资，资金来源为自有资金。

（四）其他

标的公司未被列为失信被执行人。

三、交易标的的定价情况

本次增资的定价系基于禾芯集成当前发展阶段以及未来发展潜力，在参考了市场价格、标的公司前次股东增资价格以及资产评估的预评基础上，由双方协商确定，不存在损害中小股东利益的情形。公司拟以自有资金 5,000 万元向禾芯集成增资，增资款项中的 2,600 万元计入注册资本，溢价部分计入资本公积，最终的交易价格将以已备案从事证券服务业务的评估机构出具的评估报告所载的评估值作为定价依据，以确保本次增资价格的合理、公允。

四、增资协议的主要内容

-
1. 投资方式：现金出资
 2. 投资金额：人民币 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元整）
 3. 资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金
 4. 股权安排：本次投资完成后，公司将根据禾芯集成当前注册资本及投后估值，持有其 2.27% 股权。（具体比例以最终签署的增资协议为准）

五、对外投资对上市公司的影响

公司作为国内集成电路高端封装测试领域的领军企业，参股专注于先进封测的禾芯集成，并非简单的资本布局，而是基于产业链协同的战略考虑。此次参股将从客户资源拓展、技术能力互补、先进封装生态完善三大维度，为公司构建了差异化竞争优势，进一步夯实公司在先进封测领域的行业地位。

（一）资源互补与市场拓展，突破细分领域边界

公司通过参股禾芯集成，实现了客户资源的双向赋能与市场覆盖的战略延伸，显著提升在高端芯片应用领域的客户触达能力。

一方面，公司自身已积累了丰富的优质客户基础，覆盖显示驱动、电源管理、射频前端等多个领域，核心客户包括行业头部企业，客户群体广泛分布于消费电子、智能终端等成熟应用场景。而禾芯集成则在 5G/6G、人工智能、云计算等前沿领域拥有独特的客户布局。通过参股，公司可借助禾芯集成的客户资源，快速渗透到 AI 芯片、高端算力芯片封测领域，实现从消费电子向高端工业、算力领域的客户结构升级。

另一方面，禾芯集成也可依托公司在成熟领域的客户基础与市场渠道，加速其先进封测技术的商业化落地。这种双向的客户资源互补，使得两家企业能够共享市场需求信息，共同挖掘跨领域客户的综合封测需求，形成“成熟市场稳固+高端市场突破”的客户格局，显著提升颀中科技的市场抗风险能力与长期增长潜

力。

（二）工艺协同与壁垒强化，提升核心技术竞争力

公司与禾芯集成在先进封测核心技术上的高度契合与互补，使得此次参股形成了显著的技术协同效应，进一步强化了公司的技术壁垒。

公司在以凸块制造（Bumping）和覆晶封装（FC）为核心的先进封装技术上积累了深厚经验，是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的企业，尤其在8吋及12吋显示驱动芯片全制程封测领域处于行业领先地位，同时在铜镍金凸块工艺、高精密覆晶封装等方面拥有自主创新技术，可实现成本优化与性能提升的双重目标。禾芯集成则定位在聚焦先进封测与特色封测技术，打造国内唯一的同时拥有高性能晶圆级和面板级先进封测工艺平台。

双方技术的协同效应主要体现在两个层面：一是工艺互补，公司的凸块制造、覆晶封装技术可与禾芯集成的超薄封装、2.5D/3D集成技术形成互补，共同构建从基础封装到高端集成的完整技术链条；二是研发协同，两家企业可共享研发资源，联合攻克先进封装领域的共性技术难题，例如在微尺寸凸块封装、高集成度封装等方向上加速技术迭代，进一步提升颀中科技的核心技术竞争力，巩固其在先进封装领域的技术领先地位。

（三）完善产业生态与赛道延伸，抢占未来发展先机

此次参股是公司完善先进封装产业布局、延伸产业链条、抢占高端封装赛道的关键举措，将使公司在封装技术的多元化与前沿化布局上迈出重要一步。

从公司自身布局来看，正积极推进“高端显示驱动芯片封测为主，多元芯片封测齐头并进”的战略，通过募投项目布局高脚数微尺寸凸块封装、先进功率及倒装芯片封测等领域，计划构建凸块制造、晶圆测试、覆晶封装、成品测试的全制程服务能力，并向高性能计算、自动驾驶等尖端市场拓展。而禾芯集成的业务规划恰好与公司的战略方向高度契合，其业务将分期推进，涵盖倒装技术、晶圆

级封装、面板级封装、SiP 及 2.5D/3D 封装技术，尤其在 2.5D/3D、面板级封装这一先进封装前沿赛道的布局，精准切入了人工智能、大数据时代的核心需求。

通过参股禾芯集成，公司不仅快速获得了先进封装这一高端赛道的布局机会，亦可借助禾芯集成在 5G/6G、汽车电子等领域的封装技术积累，完善自身在前沿应用领域的封装能力布局。同时，两家企业可在产能规划、供应链协同等方面形成合力，例如共享高端封装设备资源、优化原材料采购成本，进一步提升整体产业竞争力。这种“自主研发+参股赋能”的布局模式，使得公司能够快速补齐高端封装领域的短板，构建更为完善的先进封装产业生态，为后续向价值链高端延伸奠定坚实基础。

六、对外投资的风险提示

本次投资仍处于洽谈阶段，相关投资协议尚未签署。本次投资虽经充分论证，但仍可能面临行业竞争加剧、技术迭代、市场需求变化等潜在风险。公司将密切关注禾芯集成的经营状况与行业动态，通过参与公司治理、加强沟通协作等方式防范投资风险，保障公司利益。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 19 日